

# 杭州士兰微电子股份有限公司

## 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有  
限公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称“士兰集成”、“士兰集昕”、  
“美卡乐”）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年4月1日至2024  
年4月30日，公司在年度预计担保额度内为士兰集成签署了合计担保金额为4.34  
亿元的最高额担保合同，为士兰集昕签署了合计担保金额为5.00亿元的最高额  
担保合同，为美卡乐签署了合计担保金额为1.21亿元的最高额担保合同。

截至2024年4月30日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为5.03亿元，  
公司为士兰集昕实际提供的担保余额为10.28亿元，公司为美卡乐实际提供的担  
保余额为1.17亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

- 上述担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

#### （一）年度预计担保进展情况

2024年4月1日至2024年4月30日，公司在年度预计担保额度内实际发  
生的担保如下：

担保合同名称	担保合同签署日期	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式
最高额不可撤销担保书	2024年4月26日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	担保的本金余额最高限额为人民币1.00亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保

最高额不可撤销担保书	2024年4月26日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	担保的本金余额最高限额为人民币2.00亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
最高额不可撤销担保书	2024年4月26日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	担保的本金余额最高限额为人民币0.30亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
最高额保证合同	2024年4月25日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	担保的最高融资余额为人民币0.66亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
本金最高额保证合同	2024年4月2日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币0.70亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
本金最高额保证合同	2024年4月2日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币3.00亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
本金最高额保证合同	2024年4月2日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币0.25亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
最高额保证合同	2024年4月2日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	担保的债权最高余额为人民币2.64亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保

## （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2023年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过32亿元，其中对士兰集成提供日常担保不超过8亿元、对士兰集昕提供日常担保不超过13亿元、对美卡乐提供日常担保不超过2亿元。以上担保预计金额包含以前年度延续至2023年度的日常担保余额，且在2023年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上日常担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2023年3月31日和2023年4月21日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2023-015、临 2023-021 和临 2023-029。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至 2024 年 4 月 30 日，公司为士兰集成、士兰集昕、美卡乐提供的担保均为日常担保，担保余额均在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内，具体如下：

（单位：人民币 亿元）

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
士兰集成	8	5.03	2.97
士兰集昕	13	10.28	2.72
美卡乐	2	1.17	0.83

## 二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况如下：

公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)		主营业务
						直接	间接	
杭州士兰集成电路有限公司	913301017265863549	2001 年 1 月 12 日	浙江杭州	陈向东	60,000	98.75		芯片制造
杭州士兰集昕微电子有 限公司	91330101MA27W6YC2A	2015 年 11 月 4 日	浙江杭州	陈向东	224,832.8735	47.73	32.35	芯片制造
杭州美卡乐光电有 限公司	91330101689094018G	2009 年 7 月 2 日	浙江杭州	江忠永	17,000	43.00	56.29	LED 封装

（二）被担保人士兰集成最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项 目	2024年3月末/2024年1-3月 (未经审计)	2023年末/2023年度 (经审计)
资产总额	172,698	177,213
负债总额	80,518	84,401
净资产	92,180	92,812
营业收入	28,824	140,565
净利润	-633	-7,802

被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

项 目	2024年3月末/2024年1-3月 (未经审计)	2023年末/2023年度 (经审计)
资产总额	357,246	364,046
负债总额	148,227	152,078
净资产	209,019	211,968
营业收入	30,118	144,071
净利润	-2,949	2,701

被担保人美卡乐最近一年及一期的主要财务数据如下：

(单位：人民币 万元)

项 目	2024年3月末/2024年1-3月 (未经审计)	2023年末/2023年度 (经审计)
资产总额	43,198	41,975
负债总额	23,308	22,673
净资产	19,890	19,302
营业收入	8,120	21,180
净利润	588	1,224

(三) 士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
最高额不可撤销担保书	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	担保的本金余额最高限额为人民币 1.00 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止
最高额不可撤销担保书	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子公司	招商银行股份有限公司杭州分行	担保的本金余额最高限额为人民币 2.00 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	
最高额不可撤销担保书	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	担保的本金余额最高限额为人民币 0.30 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	
最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	杭州银行股份有限公司滨江支行	担保的最高融资余额为人民币 0.66 亿元及	连带责任保证担保	

	司			其利息、费用等		自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日(如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期,则为提前到期日)起叁年
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币 0.70 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币 3.00 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币 0.25 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	
最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州钱塘支行	担保的债权最高余额为人民币 2.64 亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

#### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集成、士兰集昕、美卡乐日常生产经营的资金需求,有利于公司主营业务的发展;被担保人士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为公司合并报表范围内的子公司,具备良好的偿债能力,风险可控。

#### 五、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日和

2023年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2023-015、临2023-021和临2023-029。

## 六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为48.066亿元，占公司最近一期经审计净资产的39.98%。公司对控股子公司提供的担保总额为39.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.15%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为8.216亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.83%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2024年5月7日